

■ 产品简介及特性

NDST-SPT-SG150是一种用于电子类灌封的双组份导热阻燃灌封胶，固化后产品具有一定的硬度、优良的热传导性能。该产品无溶剂，操作时间长，具有一定的延伸性，优异的导热性及阻燃性，该产品主要用于大功率电源电器灌封，特别是对导热和阻燃有要求的电子电器部件的灌封。

■ 产品技术参数

	测试项目	参考标准		
固 化 前	外 观	目测	灰色 (A) 流体	白色 (B) 流体
	粘度 (cps, 25℃)	GB/T 2794-1995	3000±500	3500±1000
操 作 性 能	双组分混合比例 (重量比)	使用体系实测	A:B=1: 1	
	混合后的比重	GB/T 6750-2007	2.3±0.1	
	表干时间 (min, 25℃)	GB/T 13477.5-2002	> 30	
	完全固化时间 (h, 25℃)	使用环境实测	24	
固 化 后	硬 度(shore A)	GB/T 531.1-2008	40±5	
	导 热 系 数 [W/(m·K)]	ASTM D5470-06	1.5±0.1	
	介 电 强 度 (kV/mm)	GB/T 1695-2006	≥12	
	体积电阻率 (Ω·cm)	GB/T 1692-2008	≥1.0×10 ¹²	
	使用温度范围 (℃)	/	-50~+200℃	
	阻燃等级	UL-94	V0	
	线性膨胀系数[um/(m·℃)]	-40~+150℃	<160	

■ 使用方法与注意事项

- 1、清理灌封表面，去除油污等。按配比称量两组份放入混合罐搅拌均匀，使之成为均一的颜色。将混合好的胶料灌封于需灌封的器件内，一般可不抽真空脱泡，若需得到高导热性建议真空脱泡后再灌注。胶的固化速度与固化温度有很大的关系，环境温度越高，操作时间越短，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，60℃~70℃下固化30分钟。
- 2、本品易被含P、S、N的有机化合物“毒化”而影响固化效果，使用时注意清洁，防止杂质混入。
- 3、本品切忌与水加入硫化剂的缩合型硅橡胶、加入固化剂的环氧树脂、聚氨酯等相混或接触。
- 4、本品属于非危险品，如不慎溅入眼睛、口或皮肤，请立即用清水进行清洗。

■ 包装、贮存、运输

- 1、包装：A组分：500g/罐（商城上架标准）；25kg/桶（出货标准）；B组分：500g/罐（商城上架标准）；25kg/桶（出货标准）。
- 2、产品应在25℃以下保存，保质期6个月。超期复检合格仍可使用。

■ 安全与环保

- 1、本产品属非危险化学品，可按照非危险品贮存和运输，使用时，对人体和环境没有毒害和污染。
- 2、使用后的包装物，请按照相关的环保规定要求进行处理，不得随意乱丢弃。

注：

- 本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据为非出厂标准值。记载的内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
- 我公司只对产品是否符合规格给予保证。由于客户的使用条件差异和产品储存运输和施工过程不受本公司控制，客户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的产品。
- 产品的部分性能参数均可根据客户的要求作专门调整。客户可与我的市场部联系。
- 本公司的有机硅产品是面向一般电子工业用途而开发。如要作为其它用途，必须按照相关的法律要求做出检测并符合要求，方可使用。
- 如果要转载本产品说明书更详细的内容，请和本公司市场部联络。